

证券代码：688783

证券简称： 西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2025-01

投资者关系 活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（投资者线上交流）</div>
---------------	---

上。

3、公司团队半导体行业有丰富的经验，请介绍一下这些经验是如何积累而来的？

答：公司核心管理团队具有丰富的重资产半导体产业成功运营经验，在客户开拓、技术研发、工厂建设、生产管理、工艺提升、质量管理等方面具有成功产业运营经验。公司的研发团队由海内外具有丰富电子级硅片成功量产经验的专家团队组成，相关人员在五大核心工艺环节均拥有深厚的技术背景及成熟量产经验。

4、2026 年公司两个工厂将满产运作，甚至高于计划产能。您认为逐步提升产量的难度或者提升效率的关键因素是什么？

答：提升产能的关键因素主要有内外两个方面，内因主要是自身综合能力建设，包括产线管理、设备稼动、品质和良率保障等。外因主要是不断匹配并满足客户既有及新工艺技术需求，并跟随或联合研发推动客户的技术迭代步伐。

5、从长期角度分析，贵公司 10 年的愿景和目标是什么？

答：公司制定了清晰的战略发展规划，计划从 2020 年至 2035 年通过 15 年的不断努力，建设 2-3 个核心基地，投资若干个硅片工厂，最终成为 12 英寸半导体硅材料领域全球领导者。

6、如果存在一些挑战，例如想要超越行业前 5，公司认为应该做些什么事情才能实现目标？

答：半导体硅材料行业系投资体量大、技术密集度高的行业，需要不断专注深耕，成为全球行业头部基本需要以下几点：

- 1、具备相当产能规模，一定规模的供应能力是更好服务全球客户的前提之一；
- 2、在大规模生产的基础上具备高水平的研发和品质控制能力并且可以不断迭代；
- 3、具备成为客户首选供应商的能力，产能扩张的前提是市场和客户认可。截至 2025 年 6 月末，公司已通过验证的客户累计 161 家，其中中国大陆客户 122 家，中国台湾及境外客户 39 家。

7、公司在进行资本投入时，是否有关于投资回报率和资本回报率方面的目标评估？

答：公司在进行资本性投入时会兼顾资本回报率和产能提升，兼顾长期利益和短期利益的平衡。公司目前净利润虽尚未转正，但经营性现金流已经持续转正并且逐步增长。随着规模效应的不断显现，公司预计 2027 年将实现净利润转正。

8、公司将如何开拓海外市场，将如何突破高端制程产品？

答：公司坚持立足国内，更放眼全球的市场策略，中短期内要达成“国内客户一供，海外客户三供”的市占率目标。公司持续导入海外客户，与多家海外头部晶圆厂持续合作并为其稳定量产供应，海外销售收入约占公司总收入的 30%，基于当前的产品验证进展，未来在销售规模增长的情况下，公司外销占比有望进一步提升。

公司产品已量产用于 2YY 层 NAND Flash 存储芯片、先进际代 DRAM 存储芯片和先进制程逻辑芯片；更先进制程 NAND Flash 存储芯片、更先进际代 DRAM 存储芯片以及更先进制程逻辑芯片所需的 12 英寸硅片均已在主流客户验证。

9、公司目前出口产品测试片还是正片？

答：公司目前出口产品中包括正片和测试片。

10、目前中国 12 英寸硅片的自给自足率大约是多少？

答：从结构角度来看，存储产品所需 12 英寸硅片国内自给率较高，基本可以实现自给自足。逻辑产品整体上所需 12 英寸硅片的自给率较低，海外采购占比约 50%以上，且制程越先进自给率越低。

11、公司如何看待这个行业的发展？竞争是否激烈？

答：全球半导体市场本轮从 2020 年开始进入景气上升周期，各国晶圆厂加速资本支出，2020 至 2023 年，全球新增投资超过 30 条 12 英寸晶圆产线。根据 SEMI 统计，截至 2024 年末，全球共有 189 条 12 英寸量产晶圆厂，预计到 2026 年全球 12 英寸晶圆厂量产数量将达到 220 座，将对 12 英寸硅片带来巨大的需求。根据 SEMI 预测，全球 12 英寸晶圆厂产能将从 2024 年的 834 万片/月增长至 2026 年的 966 万片/月，年复合增长率达到 8%，下游晶圆厂产能的快速扩张将大幅拉升 12 英寸硅片需求。

从竞争格局看，行业呈现“高壁垒、集中化”特征，全球市场长期由少数海外巨头主导，公司通过不断技术突破和产能提升，持续保持高质量发展。整体来看，行业存在结构性差异，成熟制程领域竞争较激烈，中高端制程领域目前仍大部分依赖进口。